MASK FOR PROCESSING OF RIE

Publication number:

JP11102880

Publication date:

1999-04-13

Inventor:

FUJIE TOMOE

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

H01L21/302; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/302

- European:

Application number:

JP19970260396 19970925

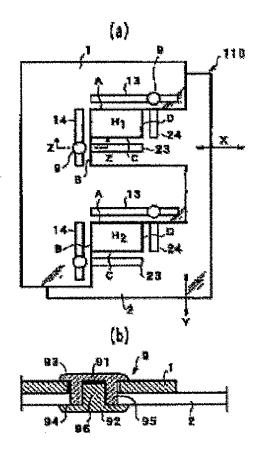
Priority number(s):

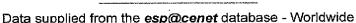
JP19970260396 19970925

Report a data error here

Abstract of JP11102880

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce manufacturing cost and material cost by a method wherein the apertures, which are formed by overlapping a pair of mask members in such a manner that adjacent sides of an opened part are rectangular, are maintained adjustable in the distance of opposing sides. SOLUTION: On a mask member 1, a groove 13 is formed in parallel in the vicinity of the side A, and a groove 14 is formed in parallel in the vicinity of the side B. On a mask member 2, a groove 23 is formed in parallel in the vicinity of the side C, and a groove 24 is formed in parallel in the vicinity of the side D. Accordingly, the groove 13 and the groove 24 are overlapped with each other, and they are intersecting at right angles to each other. A pinching device 9 is provided on the intersecting part of the grooves, and a pinching pieces 91 and 92 are fitted together. As a result, the size of apertures H1 and H2 can be changed arbitrarily by sliding the mask member 2 in the direction of arrow X for the mask member 1, and by sliding the mask member 2 in the direction of an arrow Y. As a pair of mask members are formed in advance corresponding to the interval of samples and they are coupled by a pinching device, manufacturing cost and material cost can be sharply cut down.





(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-102880

(43)公開日 平成11年(1999)4月13日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

тī

H01L 21/302

H01L 21/302

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平9-260396

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝

(22)出顧日

平成9年(1997)9月25日

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72) 発明者 藤 江 知 恵

神奈川県川崎市幸区堀川町580番1号 株

式会社東芝半導体システム技術センター内

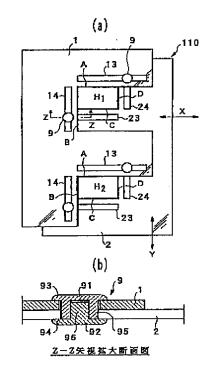
(74)代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外3名)

(54) 【発明の名称】 RIE加工用マスク

(57)【要約】

製作の手間及び材料費を大幅に低減させ、ま た、複数のサンプルに対応でき、それぞれのサンプルに 対する加工差を実質的に無くすることのできるRIE加 工用マスクを提供する。

【解決手段】 単一のシート材に複数個の開放部が形成 され、開放部を形成する隣接辺が開放部から見て直角を なす一対のマスク部材と、開放部の隣接辺が長方形をな すように一対のマスク部材を重ね合わせて複数の開口を 形成すると共に、開口の対辺距離を調整可能に保持する 保持手段とを備えたものである。保持手段は、マスク部 材にそれぞれ形成され、かつ、重ね合わせ時に互いに直 角に交差するように形成された溝と、溝を貫通しその長 手方向に移動可能にマスク部材を表裏両面から挟持する 挟持手段とで構成することができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】単一のシート材に複数個の開放部が形成され、前記開放部を形成する隣接辺が前記開放部から見て 直角をなす一対のマスク部材と、

前記開放部の隣接辺が長方形をなすように前記一対のマスク部材を重ね合わせて複数の開口を形成すると共に、前記開口の対辺距離を調整可能に保持する保持手段と、を備えたRIE加工用マスク。

【請求項2】前記保持手段は、前記マスク部材にそれぞれ形成され、かつ、重ね合わせ時に互いに直角に交差するように形成された溝と、前記溝を貫通しその長手方向に移動可能に前記マスク部材を表裏両面から挟持する挟持手段とを有する請求項1に記載のRIE加工用マスク。

【請求項3】前記保持手段は、前記マスク部材の縁部に それぞれ形成され、かつ、重ね合わせ時に互いに直角を なす方向に形成された溝と、前記マスク部材を移動可能 にその縁部を表裏両面から保持する保持枠と、前記マス ク部材の溝を通して前記保持枠を挟持する挟持手段とを 有する請求項1に記載のRIE加工用マスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子ビーム(Electron Beam)をプローブとする EBテスタでの観測を容易にするために、半導体製品のパッケージ上に搭載されたチップの保護膜や絶縁膜をエッチングする際、観測対象でない部分がエッチングされないように保護する RIE加工用マスクに関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製品に対する故障解析装置は、内 30 部ノードを直接観測できる E B テスタをはじめ、多種多様のものがある。これらの故障解析装置をいかに効率良く利用するかが、半導体製造に関わる技術者に課せられた重要な課題である。

【OOO3】従来、EBテスタで内部ノードを観測する 場合、その観測を容易にするためにRIE (Reactive I on Etching) 装置を利用して保護膜や絶縁膜を除去して いた。特に、EBテスタにおいてはできるだけ多くのサ ンプルを観測するために、複数個のサンプルをまとめて エッチングすることが多い。この場合、サンプルをチャ ンバー内に配置し、異方性エッチングによりチップ上の 保護膜や酸化膜を化学反応により剥離していく。このと き、単にサンプルを配置するだけではエッチング対象 (チップ) 以外の、例えば、ピンやワイヤ等も反応して しまうため、その化学反応を防ぐために、反応し難い素 材を使用して作成したマスクによって保護している。本 明細書ではこのマスクをRIE加工用マスクと称する。 【0004】RIE加工用マスクは、使用するエッチン グガス (CHF₃, CF₄, O₂等) によるプラズマと 反応し難く、かつ、加工が容易な素材であるテフロンシ 50 ート、マイカシート、ポリイミドテープ等を使用して、 パッケージの形状やチップの大きさに合わせて手作業で 作成していた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述したRIE加工用マスクを作成する場合、エッチング対象部分の大きさを定規で測定し、その寸法でテフロンシート又はマイカシート等を切り、貼りして作成していた。この場合、テフロンシートは加工しやすいが厚みがあるために寸法精度を確保し難く、また、耐久性が低いために使用中に変形してしまうことがあった。これに対して、マイカシートはテフロンシートよりも薄いもので済むが、割れやすいため慎重な加工作業が要求された。いずれにしても、手作業によるRIE加工用マスクの作成は大変な手間と時間を要し、寸法的に不正確なものができやすく、また、サンプル毎にマスクを作成することは材料費が高むという問題もあった。

【0006】なお、最も簡単な方法としてマスクしたい部分にポリイミドテープを貼り付けてマスクすることもできるが、ポリイミドはテフロンシートやマイカシートと比較して反応しやすく、グラス(反応生成物)の発生の原因になる場合があって長時間のエッチングに耐えられない素材であった。

【0007】特に、複数のサンプルを同時にエッチングする場合、同形状のマスクを必要な数だけ作成しなければならず、エッチング対象が同サイズであるにも拘らず形状の異なるマスクを使用するとサンプル間で加工結果に差が生じてしまう場合があった。

【0008】本発明は上記の課題を解決するためになされたもので、第1の目的は製作の手間及び材料費を大幅に低減させることのできるRIE加工用マスクを提供することにある。

【0009】本発明の第2の目的は複数のサンプルに対応でき、それぞれのサンプルに対する加工差を実質的に無くすることのできるRIE加工用マスクを提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明は、 単一のシート材に複数個の開放部が形成され、開放部を 形成する隣接辺が開放部から見て直角をなす一対のマス ク部材と、開放部の隣接辺が長方形をなすように一対の マスク部材を重ね合わせて複数の開口を形成すると共 に、開口の対辺距離を調整可能に保持する保持手段と、 を備えたRIE加工用マスクである。

【0011】請求項2に係る発明は、請求項1に記載の RIE加工用マスクにおいて、保持手段は、マスク部材 にそれぞれ形成され、かつ、重ね合わせ時に互いに直角 に交差するように形成された溝と、溝を貫通しその長手 方向に移動可能にマスク部材を表裏両面から挟持する挟 持手段とを有するものである。 【0012】請求項3に係る発明は、請求項1に記載のRIE加工用マスクにおいて、保持手段は、マスク部材の縁部にそれぞれ形成され、かつ、重ね合わせ時に互いに直角をなす方向に形成された溝と、マスク部材を移動可能にその縁部を表裏両面から保持する保持枠と、マスク部材の溝を通して保持枠を挟持する挟持手段とを有するものである。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明を好適な実施形態に 基づいて詳細に説明する。図1は本発明の第1の実施形 10 態を構成するマスク部材の形状及びその重ね合わせ状態 を示した図である。同図において、(a)に示すマスク 部材1と(b)に示すマスク部材2とは同一の形状を有 している。これらのマスク部材は、望ましくは、シート 状のマイカ又は石英で形成される。ここでは矩形のシー ト部材の縁部が切り欠かれてマスク部材1に開放部1 1, 12が形成され、マスク部材2に開放部21,22 が形成されている。このうち、マスク部材 1 の開放部 1 1.12は、この開放部から見て互いに直角の隣接辺 A. Bを有している。同様に、マスク部材2の開放部2 1. 22は、この開放部から見て互いに直角の隣接辺 C. Dを有している。このうち、マスク部材1に対して マスク部材2を180度回転させて両者を重ね合わせる と、(c)に示すように、各マスク部材の辺A,B, C, Dで囲まれる長方形の開口H, , Hz が形成され る。本実施形態はこれらの開口H:,HzをRIE加工 用マスクの窓とするものである。

【0014】図2はこのRIE加工用マスクを用いてサンプル100のエッチング対象部分(チップ)100Aをエッチングしようとするものである。この場合、2個のサンプル100が所定の間隔に配置されることを前提として、マスク部材1,2の各開放部が形成される。ところで、サンプル100どうしの間隔が決まっていたとしても、エッチング対象部分100Aの寸法は随時変わる可能性がある。そこでマスク部材1,2を相互にスライドさせる機構が必要になる。

【0015】図3はマスク部材1,2をスライドさせて開口H1,H2の大きさ、すなわち、エッチングに対する保護領域を変更可能にしたRIE加工用マスク110の構成を示す平面図及びその要部拡大断面図である。図3(a)において、マスク部材1には、辺Aと平行にしてその近傍に溝13が形成され、辺Bと平行にしてその近傍に溝14が形成されている。同様に、マスク部材2には、辺Cと平行にしてその近傍に溝23が形成され、辺Dと平行にしてその近傍に溝24が形成されている。従って、溝13と溝24とが互いに重なり、かつ、直角に交差することになる。

【0016】 これらの溝の交差部には、それぞれ、図3 (b) に示すように、挟持装置9が設けられている。なお、溝13,14,23,24はサンプルのピンやワイ 50

ヤを避けた位置に形成される。挟持装置9はマスク部材1,2と同一の素材で形成され、挟持片91と挟持片92とを嵌合させる構成になっている。このうち、挟持片91は溝13,14等の幅よりも僅かに径の大きいフランジ部93と、溝13,14等の幅よりも僅かに径の小さい嵌合凹部95とを有している。一方、挟持片92は溝13,14等の幅よりも僅かに径の大きいフランジ部94と、前記嵌合凹部95に挿入する嵌合凸部96とを有している。この場合、挟持片91の嵌合凹部95の軸方向の長さは、マスク部材1,2の厚みを合計した値よりも僅かに長く形成されている。

【0017】しかして、溝の交差部の表側から挟持片91を差込み、その裏側から挟持片92を嵌合させれば、これらが一体化される。この結果、マスク部材1に対してマスク部材2を矢印Xの方向にスライドさせたり、矢印Yの方向にスライドさせたりすることができる。この結果、開口H、H2の大きさを任意に変更することができる。

【0018】この第1の実施形態によれば、サンプル100の間隔に対応して、予め一対のマスク部材を形成し、これを挟持装置によって相互に結合すれば済むため、製作の手間及び材料費を大幅に低減させることができる。また、複数のサンプルに対する加工差を実質的に無くすることができる。

【0019】ところで、第1の実施形態は2個のサンプ ルを同時に加工するものを対象にして説明したが、より 多くのサンプルを同時に加工する必要性も出てくる。図 4は4個のサンプルを同時に加工する場合のマスク部材 の形状及びその重ね合わせ状態を示した図である。同図 において、(a)に示すマスク部材3と(b)に示すマ スク部材4とは同一の形状を有している。このうち、マ スク部材3には4個の開放部31,32,33,34が 縦と横に並べて形成されている。同様に、マスク部材 4 には4個の開放部41,42,43,44が縦と横に並 べて形成されている。このうち、マスク部材3の開放部 31~34は、この開放部から見て互いに直角の隣接辺 A. Bを有している。同様に、マスク部材4の開放部4 1~44は、この開放部から見て互いに直角の隣接辺 C. Dを有している。そして、マスク部材3に対してマ スク部材4を180度回転させて両者を重ね合わせる と、(c)に示すように、各マスク部材の辺A.B. C. Dで囲まれる長方形の開口Hu、Hz, Hz, Hz が形成される。

【0020】図5はマスク部材3, 4をスライドさせて 開口 H_n 、 H_n , H_n , H_n の大きさ、すなわち、エッチングに対する保護領域を変更可能にしたRIE加工用 マスク120の構成を示す平面図及びその要部拡大断面 図である。ここでは、前述したと同様に、マスク部材3には、20Aと平行にしてその近傍に溝35が形成されている。

同様に、マスク部材4には、辺Cと平行にしてその近傍に溝46が形成され、辺Dと平行にしてその近傍に溝45が形成されている。

【0021】そして、これらの溝の交差部には、それぞれ、(b)に示すように、前述したと全く同一の構成の挟持装置9が設けられている。この結果、マスク部材3に対してマスク部材4を矢印Xの方向にスライドさせたり、矢印Yの方向にスライドさせたりすることができる。この結果、開口Hn、Hz, Hz, Hz, O大きさを任意に変更することができる。

【0022】この構成によれば、サンプル100の間隔に対応して、予め一対のマスク部材を形成し、これを挟持装置によって相互に結合すれば済むため、製作の手間及び材料費を大幅に低減させることができる。また、複数のサンプルに対する加工差を実質的に無くすることができる。

【0024】図7は同時に加工すべきサンプルが縦にm(mは3以上の整数)個、横にn個配置され、これらのサンプルを同時に加工する場合のマスク部材7,8の加工例を示したもので、これによってm×n個のサンプルを同時に加工するのに最適なRIE加工用マスクが得られる。

【0025】図8は本発明の第2の実施形態の構成を、マスク部材の形状と合わせて示した平面図、側面図及び要部拡大断面図である。ここに示すRIE加工用マスク130は、(a)に示すように、マスク部材1の外縁部に溝15が形成され、マスク部材2の外縁部に溝23が形成されている。ここで、マスク部材1及び2の外形形状は同一であるが、マスク部材1の溝15は開放部とは反対側にあって、図面で見て縦方向に形成されているのに対して、マスク部材2の溝25は開放部と並べて、図面で見て横方向に形成されている。

【0026】これらの溝を利用して相互にスライドさせるべく、同図(b)及び(c)に示すように、一対の保持枠16,17を備えている。これらの保持枠16,17は4隅に突起部18を有し、この突起部18が相互に結合されている。そして、突起部18を除き、枠全体が2枚のマスク部材の厚み分よりも僅かに広い間隙をもっ

て重ね合わされている。この間隙に(a)に示した一対のマスク部材1,2が挿入される。また、(d)に示したように、マスク部材1の溝15を貫通して保持枠16,17を表裏両面から挟持するように、互いに離隔した一対の挟持装置9が設けられている。同様にして、マスク部材2の溝25を貫通して保持枠16,17を表裏両面から挟持するように、互いに離隔した一対の挟持装置9も設けられている。

【0027】しかして、マスク部材1は図面の縦方向に 10 配置された一対の挟持装置9をガイドとしてY方向にス ライドさせることができ、さらに、マスク部材2は図面 の横方向に配置された一対の挟持装置9をガイドとして X方向にスライドさせることができる。

【0028】かくして、図8に示した第2の実施形態によっても、製作の手間及び材料費を大幅に低減することができる。また、複数のサンプルに対する加工差を実質的に無くすることができる。

【0029】図9は上述した図3のRIE加工用マスク110のRIE装置への装着例を示す平面図及び側面図である。ここで、RIE装置200の下部電極201上にサンプル100が配置されている。下部電極201の周囲に厚みが1mmの枠状のスペーサ210が、サンプル100と上面が一致ように複数段積層されている。そして、スペーサ210上にRIE加工用マスク110を載置することによって、エッチング対象以外の部分、すなわち、ピンやワイヤ等を保護することができる。

【0030】図10は図8に示したRIE加工用マスク 130を備えたRIE装置の概略構成図である。ここ で、RIE装置200はチャンバー内にて下部電極20 1と上部電極202とを対向させて、反応性ガスプラズ マをドライエッチングする構成になっている。下部電極 201の周囲には上下移動機構を構成する支柱211を 備えている。この支柱211は図8(b)又は(c)に 示したRIE加工用マスク130の突起部18に係合す る溝が縦方向に形成されたものでなり、突起部18を溝 に沿って摺動させることによって、図9に示してスペー サ210を除去することができ、作業能率を向上させる ことができる。なお、4本の支柱211の代わりに、ラ ック及びピニオンの組合わせでなる上下移動機構を設け ても良く、あるいは、この上下移動機構をさらに水平方 向に二次元に移動する機構を付加することによって作業 能率を一層向上させることができる。

【0031】ここで、マスク材料について説明する。R IE加工する際にエッチング対象部分以外の反応を防ぐためのマスク材料として種々なものが存在するが、代表的な材料の反応性の大小を比較すると、「金>アルミニュウム>飼>プラスチック>石英」の順になる。このうち、金、アルミニュウム、銅はスパッタリングされやすく、グラス(反応生成物)の発生の原因になってしまう可能性がある。従って、マスクの素材としてプラスチッ

ク(ポイミド、テフロン等)や石英(マイカ、石英ガラ ス等)が望ましいと言える。図11はこれらの材料の加 工性、ガスとの反応性及び変形の大小を比較した図表で ある。この図表から明らかなように、手作業での加工性 に優れたポリイミドやテフロンは反応性があり、また、 変形することから同じマスクを何回も使用する点で不向 きである。

【0032】上述した実施形態ではサンプル毎にマスク を作成するというものではないため、加工のしやすさに ついては特に重視する必要はなく、何回も繰返して使用 10 する観点に立てば、反応性がなく、耐久性のあるマイカ 又は石英が最適と考えられる。

[0033]

【発明の効果】以上の説明によって明らかなように、請 求項1に係る発明によれば、単一のシート材に複数の開 放部の隣接辺が直角をなす一対のマスク部材を重ね合わ せて長方形の複数の開口を形成すると共に、開口の対辺 距離を調整可能に保持するので、製作の手間及び材料費 を大幅に低減させることができ、また、複数のサンプル に対応することが可能であり、各々に対する加工差を実 20 質的に無くする効果がある。

【0034】請求項2に係る発明によれば、マスク部材 にそれぞれ形成され、かつ、重ね合わせ時に互いに直角 に交差するように形成された溝と、溝を貫通しその長手 方向に移動可能にマスク部材を表裏両面から挟持する挟 持手段とで保持手段を構成したので、簡易な構成によっ て上記の効果を達成することができる。

【0035】請求項3に係る発明によれば、マスク部材 の縁部にそれぞれ形成され、かつ、重ね合わせ時に互い に直角をなす方向に形成された溝と、マスク部材を移動 30 可能にその縁部を保持する保持枠と、マスク部材の溝を 通して保持枠を表裏両面から挟持する挟持手段とで保持 手段を構成したので、取扱い及び応用性に優れたものが 得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態を構成するマスク部材 の形状及びその重ね合わせ状態を示した図。

【図2】図1に示した実施形態によるRIE加工状態の*

*説明図。

【図3】図1に示した実施形態の全体構成を示す平面図 及び要部拡大断面図。

【図4】本発明の第1の実施形態を構成するマスク部材 の他の形状及びその重ね合わせ状態を示した図。

【図5】図4に示したマスク部材に対応するRIE加工 用マスクの全体構成を示す平面図及び要部拡大断面図。

【図6】本発明の第1の実施形態を構成するマスク部材 の他の形状を示した図。

【図7】本発明の第1の実施形態を構成するマスク部材 の他の形状を示した図。

【図8】本発明の第2の実施形態を構成するマスク部材 の重ね合わせ状態図、全体構成を示す平面図、側面図及 び要部拡大断面図。

【図9】本発明に係るRIE加工用マスクのRIE装置 への装着状態を示した平面図及び側面図。

【図10】本発明に係るRIE加工用マスクのRIE装 置への装着状態を示した側面図。

【図11】マスクの素材と各種材料の加工性、ガスとの 反応性及び変形の大小を比較した図表。

【符号の説明】

1~8 マスク部材,

9 挟持装置

16,17 保持枠

18 突起部

11, 12, 21, 22, 31~34, 41~44 開 放部

13. 14. 23. 24. 35. 36. 45. 46 溝 51~5n, 61~6n, 711~7nm, 811~8 nm 開放部

100 サンプル

100A エッチング対象部分(チップ)

110, 120, 130 RIE加工用マスク

200 RIE装置

201 下部電極

202 上部電極

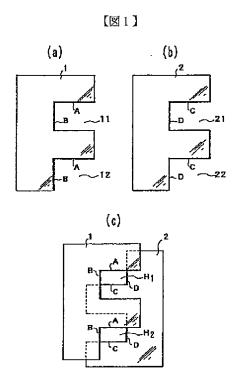
211 上下移動機構を構成する支柱

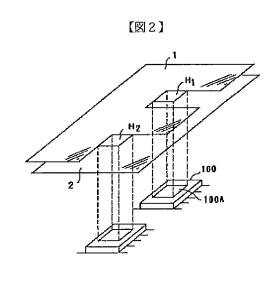
【図11】

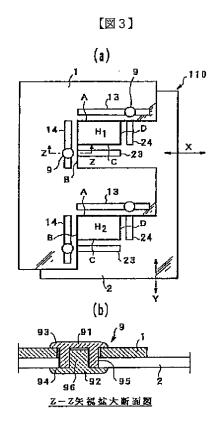
材料	ポリイミド	デフロン	マイカ	石英
加工	0	0	Δ	х
反応性	×	Δ	0	0
变形	Δ	×	0	0

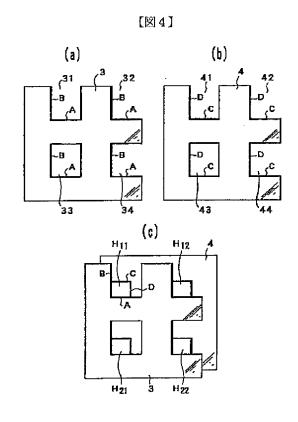
反応性--- O: しにくい 変 形--- O: 変形しない ×:グラス発生の可能性有り

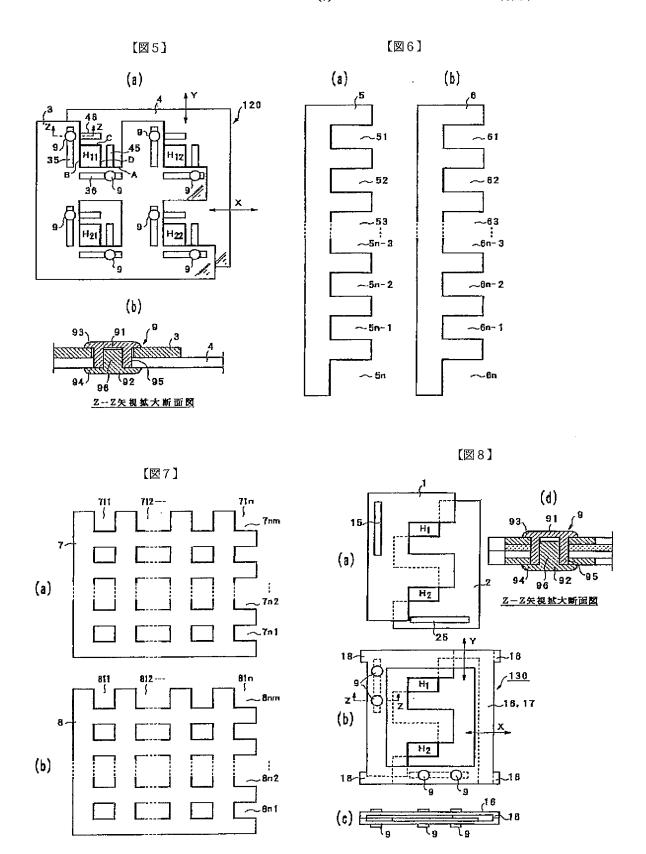
×:変形する











[図9] (a) -201 / 110:RIE加工用マスク (b)

